

レーザー描画装置



レーザー描画装置
Heidelberg Instruments
DWL66FS-S

平成21年度導入

【主な用途・仕様】

レーザー光によるフォトマスクやウェハへの描画

- ・ 最小線幅：1 μm
- ・ レーザー波長：405nm
- ・ エッジ粗さ：0.08 μm
- ・ 線幅の再現性：0.1 μm
- ・ アライメント精度：0.25 μm
- ・ 描画速度：50mm²/min
- ・ 最大描画エリア：200mm×200mm

【担当部署】 電子情報システム部：MEMS グループ

【設備使用の項目・使用料】 レーザー描画装置

【受託試験の項目・手数料】 マイクロマシニング加工（B）